

证券代码：300964

证券简称：本川智能

江苏本川智能电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投基金管理有限公司 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 福州海承投资有限公司 深圳慈曜资产管理有限公司 天风证券股份有限公司（中小盘研究团队） 财通证券股份有限公司（电子行业研究团队） 国海证券股份有限公司（电子行业研究团队） 西南证券股份有限公司（电子行业研究团队）
时间	2026年5月19日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	1、总经理江培来先生； 1、研发总监张建波先生； 2、财务负责人、董事会秘书董超先生； 3、证券事务代表魏博文先生。
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 本次投资者关系活动以现场召开的方式进行，公司与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复： 1、公司目前小批量PCB市场的竞争格局如何？其市场空间有多大？另外，公司是否有计划从小批量板生产转向大批量板生产的战略规划？ 答：PCB行业市场竞争者众多，行业集中度低，专注于小

批量板的企业数量相对较少。小批量板生产工艺流程比较复杂，对小批量板生产商的生产管理有较高的要求，进入小批量板行业的壁垒较高。小批量板应用领域较广，市场需求稳步增长，具有良好的发展前景，单位价值相对较高，具有较强的议价能力，小批量板毛利率水平通常高于大批量板。

公司遵循“模块化”的发展战略，走“小而美、专而精”的发展路线，专注于细分领域和新兴市场，以实现高质量发展格局。公司不盲目追求规模，不做大批量的红海市场产品，继续深耕定制化、小批量的高端细分市场（如 CIPB、特种基材 PCB 等），避免与大厂在红海市场竞争，暂时无转向大批量板生产的战略规划。

2、公司 CIPB 项目的技术原理、核心优势及应用场景是什么？市场前景如何？

答：CIPB（芯片埋入功率板）是新一代电力电子技术，通过将结构件、元件与 PCB 重塑集成，实现芯片与基板的一体化封装，解决传统叠层架构体积大、散热差、寄生电感高等痛点。

（1）核心技术优势

电气性能提升：相比传统模块，寄生电感降低 90%以上，开关损耗显著降低，电源转换效率大幅提升。

热管理与可靠性：通过背面直贴高导热层，结温降低 15-20 度，支持 200 度高温运行；功率循环次数超过 10 万次，是传统方案的 3-10 倍。

高集成度与小体积：省去独立驱动板和连接端子，面积缩小 30%-50%，功率密度提升 2-3 倍。

成本优势明显：通过简化结构和工艺，预计比传统方案降低成本 20%-30%。

（2）核心应用场景

AI 服务器电源：适配 450W-500W 超高功率挑战，效率提升 3%-5%，体积缩小 50%。

新能源汽车：助力逆变器实现 1200KW 高功率密度，体积缩小 1/4。

储能光伏：开关损耗降低 50%，整机效率提升 2%-4%，寿命提升 3 倍。

机器人：关节驱动体积缩小 60%-80%，响应速度提升 50% 以上。

（3）市场前景

预计到 2030 年，CIPB 对应下游市场规模广阔，其中服务器电源市场 90-250 亿元，新能源汽车 60-150 亿元，光伏逆变器 50-160 亿元，机器人模块 350-650 亿元。

3、公司当前的产能布局、扩产规划及核心业务板块情况如何？

答：

（1）产能与扩产计划

2026 年南京基地实际产量可达到 120 万平方米；珠海硕鸿工厂一期已于 2025 年开始投产，二期预计明年底建成，达产后产能预计将达到 100 万平方米；泰国基地产能规划约 40 万平方米，未来视公司经营情况及海外订单需求决定是否进一步整合扩产。

（2）核心业务板块情况

通讯设备：公司紧跟 5G/6G 技术演进、光模块迭代和卫星通信产业化趋势，不断优化产品结构，保持行业竞争优势。

工业控制：公司聚焦工业自动化设备、工业机器人等应用场景，提供高精密、高抗干扰、长寿命的 PCB 产品，适配复杂工作环境，业务发展保持稳健增长，为公司经营发展提供了稳定的收入支撑。

汽车电子：已覆盖多家国内外主流整车厂与 Tier 1 供应商，与行业领军者建立长期稳定的合作关系，持续深化战略合作。正在与部分头部车企就 CIPB 产品开展样品验证，将进一步提升公司在高端市场的份额，实现更深层次的战略绑定。

新能源领域：公司重点研发生产大功率、高可靠性的 PCB 产品，精准聚焦储能和充电桩两大核心领域，打造差异化竞争优势，成功切入多家行业头部供应链体系。

AI 领域：公司 CIPB 产品已顺利完成对头部 AI 服务器电源客户的样品验证环节，目前已正式进入其供应链体系，并开始小批量生产，持续推动商业化。

机器人领域：切入新兴赛道，为商用清洁机器人等提供定制化 PCB 解决方案，广泛应用于底盘驱动、电源管理、中央控制、伺服模组等核心部件。

（3）公司营收情况

2025 年营收同比增长 46.94%，归母净利润同比增长 33.74%；2026 年 Q1 营收同比增长 38.06%，综合毛利率约 19.26%，资产负债率较低，现金流良好。

4、公司未来主要侧重于哪些领域的发展？

答：公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局汽车电子、新能源领域，并长期深耕工业控制、电力及电源等领域。

未来公司将聚焦 AI 算力、汽车电子和通讯三大高增长驱动领域，预计整体市场规模突破 940 亿美元；加强在高频高速、CIPB 和 HDI 板领域的技术领先优势，推动 CIPB 规模化应用；深化大客户战略，积极开发全球市场。

5、公司在 AI 服务器领域具体做哪一部分？是否涉及服务器主板？

答：公司目前主要聚焦于 AI 服务器电源（一次电源）等细分市场，走差异化路线。

6、公司 CIPB 项目的商业化进展、量产准备及客户拓展情况如何？

答：公司正在进行对 CIPB 项目的厂房改造和定制化产线布

	<p>局，目前已有 6 家客户完成多版打样，3 家客户进入小批量试产阶段。</p> <p>项目目前处于小批量试产阶段，大规模放量预计在未来 1-2 年。公司已针对不同材料热膨胀系数差异导致的翘曲问题，完成 10 种以上材料验证，解决了高压绝缘、激光开槽、微孔填镀等核心技术难题；同时与上游芯片厂商、模块厂深度合作，打通了从材料到成品的全链路供应能力，为后续规模化量产做好了准备。</p> <p>7、公司 CIPB 项目业务模式是否发生转变，和功率器件厂商存在竞争关系吗？</p> <p>答：业务模式已从单一 PCB 制造商，转型为功率模块整体制造商，对外直接售卖成品模块，同时联合头部封装厂协同合作；与头部功率器件企业并非直接竞争，更多为产业协同共存关系，公司具备 PCB 到功率模块全流程一体化能力。</p> <p>8、光模块业务现阶段进展与技术储备情况？</p> <p>答：公司目前 800G 光模块相关 PCB 已实现小批量供货，对接数家客户开展样品验证。</p> <p>9、公司 CIPB 后续工艺技术发展方向是什么？</p> <p>答：嵌入式集成是 PCB 行业主流发展趋势，公司已完成埋铜、埋阻工艺积累，稳步向埋芯方向升级，持续布局埋硅、埋电容等前沿嵌入式方案，持续夯实技术壁垒。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 19 日